



2026년도 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 학생모집 공고

1. 목적

가. 글로벌 반도체 기업 연계 반도체 프로젝트 운영

- 1) 미국, 일본, 대만 등 글로벌 반도체 분야의 선진 기업들과 연계하여 IC-PBL(Industry Coupled Project Based Learning) 형식의 비교과 교육 프로그램 운영
- 2) 해외 반도체 기업의 현장을 방문하여 글로벌 반도체 생태계 및 주요 업무 역량을 파악하는 기회 제공
- 3) 해외 반도체 분야 기업 및 대학 등 협력 관계를 구축하고 산학협력 및 공동 교육 과정 운영을 활성화

나. 반도체융합전공 학생의 글로벌·창의 인재 육성

- 1) 글로벌 반도체 기업 기술 및 산업 동향과 현장 요구를 파악하여 실무형 글로벌 반도체 인재로 육성
- 2) 기업 연계 기반 프로젝트 수행을 통해 학생들은 기업 과제를 수행하고 문제해결 능력을 강화
- 3) 프로젝트 과정에서 영어 기반으로 소통하고 과제활동 및 질의응답을 진행하면서 글로벌 소통 역량 함양
- 4) 글로벌 산업 현장을 체험하여 학생들의 향후 반도체 분야 진로 설계와 취업 설계를 구체화하는 동기를 제공

2. 개요

가. 사업명: 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트

나. 프로젝트 운영기간: 2026. 8. 30.(일) ~ 9. 4.(금), 5박 6일

다. 참여대상: 반도체특성화대학사업단 「반도체융합전공」 참여학생 12명

마. 운영장소: 대만 타이베이

바. 운영내용

- 1) 대만 TSMC 연계 IC-PBL 교육 운영 및 반도체 기업 탐방
- 2) SEMICON Taiwan 2026 참관



3. 주요 내용

가. 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 수행

- 1) 글로벌 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC 등 반도체 기업 연계 프로젝트를 설계하여 운영(*기업 프로젝트 과제 설정 - 학생 프로젝트 과제 선수행 - 대만 현지 일정에서 프로젝트 피드백 - 귀국 후 프로젝트 완료)
- 2) 반도체융합전공 학생들의 기업 현장 방문 및 프로젝트에 대한 피드백
- 3) 글로벌 반도체 기업의 산업 동향 파악과 기업탐방 프로그램을 운영

나. 글로벌 반도체 산업 분야 트렌드 및 동향 파악

- 1) SEMICON Taiwan 2026 참관과 반도체 산업 분야 이슈 파악
- 2) AI와 스마트 기술(자동화, 로봇, 모빌리티 등) 트렌드 및 산업 동향 파악
- 3) 반도체 산업의 글로벌 영향에 대한 이슈 파악
- 4) 글로벌 반도체 기업의 동향과 진로 설계를 위한 탐방
- 5) SEMICON Taiwan 2026의 주제별 부스 탐방 및 자료 수집 등

다. 글로벌 기업 및 대학과의 산학 연계 네트워크 활성화

- 1) 글로벌 선진 반도체 기업 및 대학과의 연계 및 네트워크 활동
- 2) 반도체 기술 산업, 연구, 교육 환경 등을 탐방하며 교류활동 촉진

다. 프로젝트 세부 일정(안)

일자	구분(장소)	일정
2026. 8. 30. (일)	출국	1) 전북대 - 인천국제공항 이동 2) 인천국제공항 - 대만 이동 3) 대만 체류지 체크인
2026. 8. 31. (월)	기업 연계 (TSMC 등)	1) 프로젝트 연계 기업 도착 및 오리엔테이션 2) 기업 소개 및 산업 동향 프리젠테이션 3) 기업 연계 프로젝트 활동
2026. 9. 1. (화)	기업 연계 (TSMC 등)	1) 기업 연계 프로젝트 활동 지속 2) 참여학생 프로젝트 중간 피드백(기업 실무진 피드백 필수) 3) 프로젝트 보완 설계
2026. 9. 2. (수)	기업 연계 (TSMC 등)	1) 프로젝트 중간 발표 및 기업 연계 활동 마무리 2) 반도체 기업 및 대학 등 유관 기관 네트워크 활동 3) 공정팩, 연구시설 등 탐방



일자	구분(장소)	일정
2026. 9. 3. (목)	SEMICON Taiwan 2026	1) SEMICON Taiwan 2026 주제별 부스 탐방 및 자료 수집 2) 기술 세미나 및 트렌드 세션 등 참관
2026. 9. 4. (금)	기업탐방	1) 대만 소재 반도체 기업 탐방
	귀국	1) 대만 - 인천국제공항 이동 2) 인천국제공항 - 전북대 이동

4. 선발내용

가. 선발인원: 12명(총 4팀, 1팀당 3명으로 구성)

나. 신청대상: 반도체융합전공 참여학생(※ 공고일 기준 유예자 및 졸업예정자 제외)

다. 선발절차

1) 서류심사(30점) : 심사위원 평가

가) 성적 우수자

나) 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 운영에 따른 활동계획서

다) 사업단 마일리지 취득 점수

2) 면접심사(70점) : 심사위원 평가

- 신청 팀별 PT 발표에 대한 면접 평가(10분 이내, 팀 구성원 전원 참석)

- 신청 동기, 프로젝트 주제에 대한 이해도, 활동 계획의 구체성 및 적극성, 팀별 역할 분배와 참여도, 향후 활동 및 진로 계획 등 정성평가

- 필요시 외국어(영어 또는 중국어) 성적 보유 확인 및 면접 심사에서 외국어 발표를 진행하여 심사 결과에 반영할 수 있음

3) 심사기준(안)



구분	평가항목	배점	점수	비고
서류심사 (정량)	1) 지원동기 적절성	10	30	※ 심사 점수가 동점일 경우, 팀 구성원 전체 성적의 평균 평균 점수가 우수한 팀을 선발
	2) 활동 후 학업역량 발전 가능성	10		
	3) 사업단 마일리지 취득 점수	10		
면접심사 (정성)	1) 신청 동기	10	70	※ 마일리지는 2026년도의 참여 실적을 팀별 평균 산출하여 정량평가 ※ 팀 구성원 전원이 발표해야 하며, 발표 결과 이후 서류 심사 점수를 종합하여 선발 여부 최종 결정
	2) 프로젝트 주제에 대한 이해도	10		
	3) 활동 계획의 구체성 및 적극성	10		
	4) 팀별 역할 분배 및 참여도	10		
	5) 향후 활동 및 진로 계획	10		
	6) 발표 자세 및 태도	20		
합계			100	

라. 신청방법

1) 팀 구성: 1팀당 3명으로 구성

※ 신청 후 구성원 변경 불가, 변경시 취소 후 차순위 팀 선발

2) 제출서류

- 신청서류를 구비하여 사업단 담당자 E-mail로 제출

(조정목 선임연구원, jmjo@jbnu.ac.kr)

- 메일제목 및 파일명: 2026 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트_팀명_팀장명

구분	제출서류	비고
신청 시	참가신청서	<서식1>
	활동계획서	<서식2>
	개인정보수집·활용동의서	<서식3>
	어학증명서 사본	보유시 제출(영어, 중국어 등), 공고일 기준 2년 이내 취득만 인정
	성적증명서	2026.06.01. 이후 발급분만 인정
	재학증명서	2026.06.01. 이후 발급분만 인정
서류 합격 후	발표자료	10분 이내 발표, 자유양식
최종 선정 후	서약서	<서식4>, 선정자 대상 추후 안내
	보호자 동의서	<서식5>, 선정자 대상 추후 안내
활동 이후	활동보고서	<서식6>, 선정자 대상 추후 안내

※ 제출 서류는 한 번에 스캔하여 PDF 파일 1개로 제출(발표자료만 별도 제출)

※ 발표자료 파일명: 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 발표 자료_팀명_팀장명(ppt, pdf 등으로 제출)



마. 추진 일정

구분	기간	내용
신청 서류 접수	2026. 7. 24.(금) ~ 7. 27.(월)	- 사업단 담당자 E-mail 제출
서류심사	2026. 7. 28.(화)	- <서식>의 서류심사 기준에 따라 평가
서류심사 합격자 발표	2026. 7. 28.(화)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
발표자료 제출	2026. 7. 29.(수)까지	- 사업단 담당자 E-mail 제출
면접심사	2026. 7. 30.(목)	- PT 발표 및 면접심사 진행 - 심사 일시 추후 확정하여 공지
최종 합격자 발표	2026. 7. 31.(금)	- 사업단 홈페이지 공지 및 개별 통보
프로젝트 사전 교육	2026. 8월 중	- 프로젝트 사전 교육 및 준비
프로젝트 활동 참여	2026. 8. 30.(일) ~ 2026. 9. 4.(금)	- 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 활동
결과보고	프로젝트 참여 후 1주일 이내	- 활동보고서 및 참여수기 제출

※ 위 일정은 사업단 운영 상황에 따라 변동 가능

바. 신청 학생 유의사항

- 1) 해당 계획은 2026학년도 2학기 중 수강신청 변경 기간 동안 운영되며, SEMICON Taiwan 2026 기간 중 참여를 위해 일정이 확정되었음

※ 본 프로젝트 참여 기간에 대한 공결 처리는 발행 불가능하며, 수강신청 변경 기간 중 운영됨에 따라 발생하는 수강신청 상의 이슈는 사업단에서 책임지지 않음

- 2) 신청자는 관련 서류를 누락 없이 반드시 제출하고, 사업단 요청이 있을 경우 활동 및 성과 보고 등에 성실히 참여해야 함
- 3) 지원자는 공고 및 유의사항 내용을 충분히 숙지하지 않음으로 인해 발생하는 불이익이 없도록 내용을 꼼꼼히 확인한 후 신청해야 함
- 4) 다음 사항에 해당되는 경우임에도 신청한 경우는 참가 자격 박탈 및 위약금이 부과될 수 있으므로 자격 확인 후 신청해야 함





- 휴학, 자퇴, 취업 등 재학생 신분을 포기하였을 경우(*반도체융합전공 중도포기 시에도 위약금 대상에 해당)
- 개인적인 사정으로 프로그램 참가를 포기하였을 경우
- 신청 서류의 내용이 사실과 다른 경우
- 프로그램 진행 과정 전체에 불성실하게 임할 경우
- 제출서류를 기한 내 제출하지 않을 경우
- 프로그램 중 무허가 개인 활동으로 인해 문제가 발생한 경우

사. 참여학생 지원사항

- 지원내용: 항공료, 숙박비, 식비, 체류 중 이동 및 교통비, 기업 연계 프로젝트 관련 활동비(장비 및 공간 사용료 등), 입장료, 여행자보험 등 프로그램 관련 비용 지원
- 지원불가: 여권 발급비, 개인 비용(용돈, 선물 등)
- 실험·실습 교육과정을 위한 휴대용 기기(노트북, 태블릿PC 등) 개별 지참
- 참여학생 마일리지: 결과보고서 제출 확인 후 30점 부여

아. 신청문의

- 전북대학교 반도체특성화대학사업단 선임연구원 조정묵(063-219-5793)





항목		산출근거	금액(원)	예산과목
프로그램 운영 용역 (나라 장터 입찰)	경비	항공 750,000원×12명 = 9,000,000원 숙박 200,000원×5일×12명=12,000,000원 식비 35,000원×11회×12명=4,620,000원 국내외교통 800,000원×8회=6,400,000원	32,020,000	도비_ 교육연구프로그 램개발운영비_ 외부위탁용역비
	프로그램	기관방문 600,000원×14명=8,400,000원 기업전문가 400,000원×6명=2,400,000원 전문통역 800,000원×5일=4,000,000원 기타프로그램 15,000원×6일×14명=1,260,000원	16,060,000	
	일반 수용비	프로그램기획 900,000원×5일=4,500,000원 업체인솔담당 600,000원×6일×1명=3,600,000원 제반업무 2,000,000원×1회=2,000,000원 여행자보험 25,000원×14명=350,000원 기타수용비 560,910원	11,010,910	
	이윤	(경비+프로그램+일반수용비)의 10%	5,909,090	
	부가세	(경비+프로그램+일반수용비+이윤)의 10%	6,500,000	
	소계 (A)		71,500,000	
사무용품		-홍보 플래카드 제작 140,000원 × 1식 =140,000원 -프로젝트 사전교육 자료 제작 30,000원×12부 =360,000원	500,000	도비_그밖의사 업운영경비_ 출장비/회의비/ 사무용품
회의비		-프로젝트 사전교육 50,000원 × 2회 × 15명	1,500,000	
출장비		-인솔자 국외출장비(실비) 4,000,000원 × 2명	8,000,000	
소계 (B)			10,000,000	
합계 (A+B)			81,500,000	

※ 인솔자 국외 출장비(항공권, 숙박, 식비, 일비 등)는 「공무원 여비 규정」에 따라 별도 실비 지급

※ 프로그램 운영 상황에 따라 세부내역 및 항목 간 금액이 조정될 수 있음(환율: USD 1,541.41원, 2026. 6. 15. 기준)

기준일 : 2026년 06월 15일

고시일시 : 2026년 06월 15일 17시00분00초 (569회차)

조회시각 : 2026년 06월 15일 17시01분45초

통화	현찰				송금		외화 수표 파실때	매매 기준율	환가 료를	미화 환산율
	사실 때		파실 때		보낼 때	받을 때				
	환율	Spread	환율	Spread						
미국 USD	1,541.41	1.75	1,488.39	1.75	1,529.70	1,500.10	1,497.80	1,514.90	5.48312	1.0000





[서식 1] 참가신청서

글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 참가신청서

1. 팀 구성

팀명						
구분	학부(과)	학번	학년	성명	연락처	역할
팀장						
팀원						
팀원						

2. 활동 내용

활동기간	2026. 8. 30.(일, 출국일) ~ 2026. 9. 4.(금, 귀국일)
활동장소	대만 타이베이 외(TSMC, SEMICON Taiwan 2026 등)
활동내용 개요	1. - 2. - 3.

상기인은 글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 참가신청서를 다음과 같이 제출합니다.

2026. 6. .

팀장: (서명)

팀원: (서명)

팀원: (서명)

전북대학교 반도체특성화대학사업단장 귀하





[서식 2] 활동계획서

글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 활동계획서

1. 지원동기

이번 기업 연계 반도체 프로젝트 지원동기를 구체적으로 작성합니다.

2. 활동 계획 및 내용

계획(안)의 프로젝트 내용에 대한 주요 활동 계획 및 얻고 싶은 성과를 구체적으로 작성합니다.(프로젝트 일정(안)을 고려하여 작성할 것)

3. 향후 진로 계획

이번 프로젝트를 통해 얻은 경험을 향후 진로에서 어떻게 활용할 것인지 구체적으로 작성합니다.



4. 활동 일정

일자	구분	활동내용	비고
2026. 8. 30. (일)	출국		
2026. 8. 31. (월)	기업 연계 프로젝트		
2026. 9. 1. (화)	기업 연계 프로젝트		
2026. 9. 2. (수)	기업 연계 프로젝트		
2026. 9. 3. (목)	SEMICON Taiwan 2026		
2026. 9. 4. (금)	기업탐방 외, 귀국		





[서식 3] 개인정보 수집·활용 동의서

<개인정보 수집·활용 동의서>

전북대학교 반도체특성화대학사업단은 지원자의 개인정보를 중요시하며, 개인정보에 관한 법률을 준수하고 있습니다. 전북대학교 반도체특성화대학사업단은 다음의 개인정보취급방침을 통하여 지원자가 제공하는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.

1. 수집하는 개인정보의 항목 및 구분

전북대학교 반도체특성화대학사업단은 합격자 선정을 위하여 다음의 개인정보를 수집하여 최종 합격자 선발 시까지 활용하고 있습니다.

- 수집 항목: 신청서에 포함된 성명, 학번, 연락처, 주민등록번호, 여권번호 등 개인정보
- ※ 주민등록번호 및 여권번호는 최종 합격자에 한하여 수집

2. 개인정보의 제3자 제공

전북대학교 반도체특성화대학사업단은 지원자의 개인정보를 원칙적으로 외부에 제공하지 않습니다. 다만 합격자 선정을 위하여 평가위원에게 제공되는 지원서에 포함된 개인정보는 사전에 동의한 경우에 제한적으로 제공됩니다.

- 제공 항목: 성명, 학번, 연락처, 주민등록번호, 여권번호 등 개인정보
- 제공 목적: 합격자 선정
- ※ 주민등록번호 및 여권번호는 최종 합격자에 한하여 수집

3. 거부권 및 거부 시 불이익

위 개인정보의 수집·이용·제공과 관련하여 개인정보 동의를 거부할 수 있습니다. 만약 동의하지 않을 경우 합격자 선발 시 불이익이 있을 수 있으니 원활한 선발 심사를 위하여 동의하여 주시기 바랍니다.

<개인정보 수집·이용·제공 동의>

■ 개인정보 수집 및 제3자에 개인정보 제공 : (동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐)

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용 외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」등 관련 법률에 의거하여 본인은 위와 같이 개인정보의 수집 및 제3자 제공에 동의함

2026. 6. .

성명 : (서명 또는 인)





[서식 4] 서약서

서약서

본인은 전북대학교 반도체특성화대학사업단의 「글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트」에 성실하게 임하고, 학생의 본분에 충실하며, 다음 사항을 준수할 것을 확약하며 다음과 같이 서약서를 제출합니다.

1. 본인은 반도체특성화대학사업단의 지도, 감독에 따라 지켜야 할 규범을 준수하겠습니다.
2. 본인은 팀원 간에 서로 존중하고 소통하며, 실험·실습 프로그램 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 매사에 적극적으로 참여하겠습니다.
3. 본인은 각종 안전사고에 주의를 다하고, 허가받지 않고 자신의 부주의로 발생한 사고에 대해서 직접 책임을 지겠습니다. 또한 응급사태가 발생할 경우 학교 및 가정에 신속하게 알리고 조치를 취하겠습니다.
4. 위의 내용을 준수하지 않을 경우 지원 금액을 전액 반납하고 이에 따른 어떠한 제재조치도 감수할 것을 서약합니다.

2026. . .

학번 : 성명 : (서명)

반도체특성화사업단장 귀하





[서식 5] 보호자 여행 동의서

보호자 동의서

신청자			성명
소속학부(과)		학번	
여행기간	2026. 8. 30.(일, 출국일) ~ 2026. 9. 4.(금, 귀국일)		
여행국가	대만(타이베이 외)		
프로그램명	글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트		

본인은 _____의 보호자로서 _____가 반도체특성화대학사업단에서 실시하는 반도체 신사유람단 프로그램 활동을 하는 것에 동의하며, 만약 상기자가 신청 후 중도 포기하게 될 경우에 지원금액 전액을 반납하며, 활동 기간 중 상기자의 허가 받지 않은 행동이나 부주의로 인해 발생한 모든 사고에 대해 동의자가 책임질 것을 서약합니다.

여행 동의자 관계 :

성명 :

(서명)

여행 동의자 주소 :

여행 동의자 연락처 :

2026. . .

반도체특성화사업단장 귀하





[서식 6] 활동보고서

글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 활동보고서

1. 팀 구성

팀 명						
팀 원 구 성	No	성명	학부(과)	학번	학년	연락처
	팀장					
	팀원					
	팀원					

2. 활동 내용

활 동 기 간	2026. 8. 30.(일, 출국일) ~ 2026. 9. 4.(금, 귀국일)
활 동 장 소	대만(타이베이 외)
활 동 내 용 요 약	

「글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트」 활동보고서를 다음과 같이 제출합니다.

2026. . .

팀장 : _____ (서명)

반도체특성화사업단장 귀하





활동일지 [개인별/매일 작성]					
팀 명					
학부(과)		학 번		성 명	
연 락 처		E-mail			
활동일시		활동장소			
활동 수기	<작성요령> • 함초롱바탕, 글씨크기 11pt, 장평: 100%, 자간: 0%, 줄간격: 160% • 일자별 활동 내용 및 소감 작성 • 일자별 활동사진 3장 이상 첨부				
활동 소감					





증빙자료(활동사진 등)	
사진 제목(날짜, 활동 장소)	사진 제목(날짜, 활동 장소)
사진 제목(날짜, 활동 장소)	사진 제목(날짜, 활동 장소)





[서식 7] 심사표

글로벌 기업 연계 반도체 프로젝트 참가신청팀 심사표

팀	명	팀구성원	
---	---	------	--

구분	항 목	평가점수				
서류심사 (정량, 30점)	평가기준	매우좋음 (10)	좋음 (8)	보통 (6)	미흡 (4)	계
	1) 지원동기 적절성(10)					
	2) 활동 후 학업역량 발전 가능성(10)					
	3) 사업단 마일리지 취득 점수(10)					
소계(A)		-				
발표심사 (정성, 70점)	평가기준	매우좋음 (10)	좋음 (8)	보통 (6)	미흡 (4)	계
	1) 신청 동기					
	2) 프로그램 주제에 대한 이해도					
	3) 활동 계획의 구체성 및 적극성					
	4) 팀별 역할 분배 및 참여도					
	5) 향후 활동 및 진로 계획					
	평가기준	매우좋음 (20)	좋음 (18)	보통 (16)	미흡 (14)	계
	6) 발표 자세 및 태도					
소계(B)		-				
합 계(A+B)		_____/100점				

기타의견 :

※ 팀 평가 결과 해당항목의 점수 해당 항목에 ○표시로 기록해 주시기 바랍니다.

서류심사 채점	반도체특성화대학사업단	(서명)
발표심사 위원	반도체특성화대학사업단	(서명)

반도체특성화사업단장 귀하





[별첨] 서류심사 기준

평가기준		매우 좋음 (10)	좋음 (8)	보통 (6)	미흡 (4)
서류심사 (30점)	1) 지원동기 적절성(10)	심사위원 평가	심사위원 평가	심사위원 평가	심사위원 평가
	2) 활동 후 학업역량 발전 가능성(10)	심사위원 평가	심사위원 평가	심사위원 평가	심사위원 평가
	3) 사업단 마일리지 취득 점수(10)	팀원평균 90점 이상	팀원평균 60점 이상	팀원평균 30점 이상	팀원평균 30점 미만

※ 마일리지는 2026년도(4차년도) 사업에서 누적한 점수만 반영

※ 어학성적 제출 학생의 TOEIC - TOEIC Speaking Test Level 점수 확인은 아래 비교표 참고
(중국어 성적은 보유 여부를 확인하는 것으로만 평가에 참고)

TOEIC Speaking Test Level	TOEIC 평균점수
Advanced High	975
Advanced Mid	945
Advanced Low	895
Intermediate High	815
Intermediate Mid 3	750
Intermediate Mid 2	700
Intermediate Mid 1	660
Intermediate Low	600
Novice High	480
Novice Mid / Low	360

